第27回

最先端実装技術・パッケージング展(2013マイクロエレクトロニクスショー)出展のお知らせ

テストチップをコアとした次世代半導体先端実装ソリューションプロバイダーの株式会社ウェル (所在地:東京都品川区、代表取締役:江田尚之)は、2013年6月5日(水)

 \sim 7日(金) 東京ビッグサイトで開催されます第27回 最先端実装技術・パッケージング展内 eXtech2013に出展します。

高密度ラジカル大気圧プラズマ装置はアルゴン・窒素ガスを一切必要としない低ランニングコストと高速処理を実現しました。

大気圧下で高密度のラジカルイオンのみを発生させることで、ワーク材質に依存しないプラズマ 照射が可能となっております。

特に、半導体素子へのプラズマ照射には大変有効なプラズマとして、すでに半導体・液晶実装工程にて導入実績がございます。

□特徴

- ・低ランニングコスト(アルゴン・窒素ガスを一切必要としない)
- ・高密度ラジカル照射による半導体素子へのダメージレス
- ・高速処理(弊社アルゴンプラズマ比3~5倍の高速処理を実現)

口主な用途

- ・半導体ICパッド部ドライ洗浄
- ・ダイボンディング前処理
- ·超音波接合前処理
- 各種材料の表面改質(親水化、疎水化処理)
- ・液晶基板の端子洗浄
- ・FPC基板の表面改質
- ・ビルドアップ基板のデスミア処理

■第27回 最先端実装技術・パッケージング展 (eX-tech2013) 概要

[会期] 2013年6月5日(水) ~6月7日(金) 3日間

[開場時間] AM10:00~PM5:00

「会場]東京ビッグサイト (東京都江東区有明3-21-1)

[ブース] 3N-12

[出展内容]

高密度ラジカル大気圧プラズマ装置

先端実装評価用TSV付TEGチップ

TSV& MEMS加工サービス バンプ加工サービス

≪本件に関するお問い合わせ≫

株式会社ウェル 実装ソリューション営業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-25 サンウッド品川天王洲タワー2F

Tel: 03-5715-3501 Fax: 03-5715-3502 info@welljp.co.jp

http://well-plasma.jp/

Generated by ぷれりりプレスリリース

https://www.prerele.com